



## 2024年3月期 決算短信〔日本基準〕(連結)

2024年4月25日  
上場取引所 東

上場会社名 新光電気工業株式会社  
コード番号 6967 URL <https://www.shinko.co.jp>  
代表者 (役職名) 代表取締役社長 (氏名) 倉嶋 進  
問合せ先責任者 (役職名) 経営企画室長 (氏名) 清野 貴博 TEL 026-283-1000  
定時株主総会開催予定日 2024年6月26日 配当支払開始予定日 ー  
有価証券報告書提出予定日 2024年6月27日  
決算補足説明資料作成の有無 : 無  
決算説明会開催の有無 : 無

(百万円未満切捨て)

### 1. 2024年3月期の連結業績(2023年4月1日～2024年3月31日)

#### (1) 連結経営成績

(%表示は対前期増減率)

	売上高		営業利益		経常利益		親会社株主に帰属する 当期純利益	
	百万円	%	百万円	%	百万円	%	百万円	%
2024年3月期	209,972	△26.7	24,810	△67.7	27,257	△65.4	18,609	△65.8
2023年3月期	286,358	5.3	76,712	7.4	78,755	3.9	54,488	3.5

(注) 包括利益 2024年3月期 20,657百万円 (△63.1%) 2023年3月期 56,047百万円 (4.4%)

	1株当たり 当期純利益	潜在株式調整後 1株当たり当期純利益	自己資本 当期純利益率	総資産 経常利益率	売上高 営業利益率
	円 銭	円 銭	%	%	%
2024年3月期	137.73	—	7.2	7.0	11.8
2023年3月期	403.32	—	24.1	22.3	26.8

(参考) 持分法投資損益 2024年3月期 ー百万円 2023年3月期 ー百万円

#### (2) 連結財政状態

	総資産	純資産	自己資本比率	1株当たり純資産
	百万円	百万円	%	円 銭
2024年3月期	393,750	264,977	67.3	1,961.09
2023年3月期	386,934	251,014	64.9	1,857.90

(参考) 自己資本 2024年3月期 264,977百万円 2023年3月期 251,014百万円

#### (3) 連結キャッシュ・フローの状況

	営業活動による キャッシュ・フロー	投資活動による キャッシュ・フロー	財務活動による キャッシュ・フロー	現金及び現金同等物 期末残高
	百万円	百万円	百万円	百万円
2024年3月期	45,464	△73,273	△6,886	82,475
2023年3月期	118,223	△65,199	△7,197	115,592

### 2. 配当の状況

	年間配当金					配当金総額 (合計)	配当性向 (連結)	純資産配当率 (連結)
	第1四半期末	第2四半期末	第3四半期末	期末	合計			
	円 銭	円 銭	円 銭	円 銭	円 銭	百万円	%	%
2023年3月期	—	25.00	—	25.00	50.00	6,755	12.4	3.0
2024年3月期	—	25.00	—	0.00	25.00	3,377	18.2	1.3
2025年3月期(予想)	—	0.00	—	0.00	0.00		—	

### 3. 2025年3月期の連結業績予想(2024年4月1日～2025年3月31日)

(%表示は、通期は対前期、四半期は対前年同四半期増減率)

	売上高		営業利益		経常利益		親会社株主に帰属 する当期純利益		1株当たり 当期純利益
	百万円	%	百万円	%	百万円	%	百万円	%	円 銭
第2四半期(累計)	115,000	9.4	16,000	39.5	16,000	13.7	11,000	12.5	81.41
通 期	250,000	19.1	44,000	77.3	45,000	65.1	30,000	61.2	222.03

※ 注記事項

(1) 期中における重要な子会社の異動(連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動): 無

(2) 会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示

① 会計基準等の改正に伴う会計方針の変更 : 無

② ①以外の会計方針の変更 : 無

③ 会計上の見積りの変更 : 無

④ 修正再表示 : 無

(注) 詳細は、添付資料15ページ「4. 連結財務諸表および主な注記(5)連結財務諸表に関する注記事項(連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項)」をご覧ください。

(3) 発行済株式数(普通株式)

① 期末発行済株式数(自己株式を含む)

2024年3月期	135,171,942株	2023年3月期	135,171,942株
2024年3月期	54,462株	2023年3月期	65,449株
2024年3月期	135,114,166株	2023年3月期	135,101,481株

② 期末自己株式数

③ 期中平均株式数

(参考) 個別業績の概要

1. 2024年3月期の個別業績(2023年4月1日~2024年3月31日)

(1) 個別経営成績

(%表示は対前期増減率)

	売上高		営業利益		経常利益		当期純利益	
	百万円	%	百万円	%	百万円	%	百万円	%
2024年3月期	202,350	△26.8	23,735	△67.8	28,014	△64.4	19,480	△64.5
2023年3月期	276,581	5.1	73,628	6.9	78,587	5.6	54,850	6.0

	1株当たり 当期純利益	潜在株式調整後 1株当たり当期純利益
	円 銭	円 銭
2024年3月期	144.18	—
2023年3月期	406.00	—

(2) 個別財政状態

	総資産	純資産	自己資本比率	1株当たり純資産
	百万円	百万円	%	円 銭
2024年3月期	388,261	260,164	67.0	1,925.47
2023年3月期	381,917	247,493	64.8	1,831.84

(参考) 自己資本 2024年3月期 260,164百万円 2023年3月期 247,493百万円

※ 決算短信は公認会計士または監査法人の監査の対象外です。

※ 業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項

業績予想は、本資料の発表日現在において入手可能な情報に基づき作成したものであります。

実際の業績は、今後さまざまな要因によって予想数値と異なる結果となる可能性があります。

なお、業績予想に関する事項は添付資料3ページ「1. 経営成績等の概況 (1) 当期の経営成績の概況 ② 今後の見通し」をご覧ください。

○添付資料の目次

1. 経営成績等の概況	2
(1) 当期の経営成績の概況	2
(2) 当期の財政状態の概況	4
(3) 利益配分に関する基本方針および当期・次期の配当	5
2. 経営方針	6
(1) 経営の基本方針	6
(2) 中長期的な経営戦略	6
3. 会計基準の選択に関する基本的な考え方	7
4. 連結財務諸表および主な注記	8
(1) 連結貸借対照表	8
(2) 連結損益計算書及び連結包括利益計算書	10
連結損益計算書	10
連結包括利益計算書	11
(3) 連結株主資本等変動計算書	12
(4) 連結キャッシュ・フロー計算書	14
(5) 連結財務諸表に関する注記事項	15
(継続企業の前提に関する注記)	15
(連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項)	15
(追加情報)	17
(セグメント情報)	18
(1株当たり情報)	20
(重要な後発事象)	20
参考資料	21

## 1. 経営成績等の概況

### (1) 当期の経営成績の概況

#### ① 当期の経営成績

当連結会計年度の経済環境は、日本におきましては、新型コロナウイルス感染症の5類移行に伴い、社会・経済活動の正常化が進んだことに加え、雇用・所得環境の改善による個人消費の持ち直しなどにより、景気は緩やかな回復傾向が継続しましたが、原材料価格の高騰や円安等の影響により物価上昇が進むなど、先行き不透明な状況が続きました。海外におきましては、米国では、良好な雇用環境や個人消費を背景に景気は堅調に推移したものの、中国では、不動産市況低迷や消費意欲の減退が継続するなど、景気の減速感が強まりました。また、各国における金融引き締めの継続やインフレの高止まりに加え、ロシア・ウクライナ紛争の長期化や中東地域をめぐる情勢などを背景に、世界経済は不安定な状況のまま推移しました。

半導体業界につきましては、AI向け半導体の需要拡大に伴う市場環境の改善が一部に見られるものの、パソコン、サーバー市場の低迷継続や、買い替えサイクル長期化等によるスマートフォン需要の減少、米国による対中半導体輸出規制ならびに在庫調整の影響などにより、市況低迷が長期化する厳しい環境が続きました。

このような環境下において、当社グループにおきましては、パソコン、スマートフォン需要低迷や在庫調整の長期化等を背景とする半導体市況回復の遅れの影響を大きく受けました。こうした厳しい市場環境の下、収益確保をはかるべく受注獲得および生産性向上、コストダウン等に注力しました。また、これまで継続的に取り組んでまいりました成長市場向けの設備投資につきましては、市況環境をふまえ、計画の一部見直しを行いました。半導体市場の中長期的な拡大や当社製品の今後の需要増加を見据え、引き続き重点的に経営資源を投下しました。半導体の一層の高機能化・高速化や省電力化等のニーズに対応するフリップチップタイプパッケージについては、新たな生産拠点として千曲工場（長野県千曲市）の工場建屋が竣工するなど、引き続き生産体制強化に向けた取り組みを推進いたしました。また、さらなる大型化、高多層化、高密度微細配線等の実現に対応する当社開発の「i-THOP®」等の先端半導体向け次世代フリップチップタイプパッケージに関する千曲工場における新たな設備投資計画が、「経済施策を一体的に講ずることによる安全保障の確保の推進に関する法律」に基づく「供給確保計画」に認定され、助成金の交付が決定されました。半導体メモリーの高速化・大容量化に対応するプラスチックBGA基板については、生産能力増強をはかるべく、新井工場（新潟県妙高市）において新棟建設に着手しました。

それらの結果、フリップチップタイプパッケージは、パソコン・サーバー需要の回復の遅れ等により売上が大きく減少しました。また、半導体製造装置向けセラミック静電チャックは半導体輸出規制に加え、市況悪化の影響を受け売上が大きく減少し、リードフレームは在庫調整を背景に減収となるなど、総じて市況低迷の影響を受けました。これらにより、当連結会計年度の売上高は2,099億72百万円（前連結会計年度比26.7%減）となりました。利益面につきましては、売上高減少の影響を大きく受け、経常利益は272億57百万円（前連結会計年度比65.4%減）、親会社株主に帰属する当期純利益は186億9百万円（同65.8%減）となりました。

なお、2023年12月12日付「JICC-04株式会社による当社株式に対する公開買付けの開始予定に係る賛同の意見表明及び応募推奨に関するお知らせ」で公表しましたとおり、JICC-04

株式会社による当社の普通株式に対する公開買付けに関して、同日時点における当社の意見として、本公開買付けが開始された場合には、本公開買付けに賛同の意見を表明するとともに、当社の株主の皆様に対して、本公開買付けに応募することを推奨する旨を同日開催の取締役会において決議しております。

セグメント別の状況は次のとおりであります。

#### プラスチックパッケージ

フリップチップタイプパッケージは、コロナ特需の反動などによるパソコン・サーバー需要回復の遅れや競争激化などにより、大幅な減収となりました。プラスチックBGA基板は先端メモリ向けが在庫調整の影響を受け、IC組立はスマートフォン市場の減速によりハイエンドスマートフォン向けの需要が減少するなど、それぞれ売上が減少しました。

これらの結果、当セグメントの売上高は1,277億52百万円（前連結会計年度比27.8%減）、経常利益は売上高減少の影響を大きく受け118億28百万円（同75.0%減）となりました。

#### メタルパッケージ

半導体製造装置向けセラミック静電チャックは、米国による対中半導体輸出規制やメモリ市況悪化などの影響を受け、大幅な減収となりました。リードフレームは、半導体市況低迷による在庫調整等を背景に受注が減少し、また、CPU向けヒートスプレッダーは、パソコン・サーバー需要減退等の影響を大きく受け、ガラス端子は光学機器向けが低調に推移し、それぞれ売上が減少しました。

これらの結果、当セグメントの売上高は738億78百万円（前連結会計年度比25.6%減）、経常利益は売上高減少の影響を大きく受け161億33百万円（同48.3%減）となりました。

なお、上記のセグメント別の売上高は外部顧客への売上高であり、経常利益はセグメント間取引調整前のものです。

## ② 今後の見通し

今後の経済環境は、世界的な金融引き締めによる景気停滞懸念や中国経済の減速、また、地政学リスク等を背景としたエネルギー・物流価格の高止まりが見込まれるなど、世界経済の先行きは不透明な状況が継続するものと思われれます。日本におきましては、賃上げ等に伴う雇用・所得環境の改善、インバウンド需要の一層の増加などが期待されるものの、エネルギーや資源価格の高騰および円安等に伴う物価上昇、金利変動等による個人消費や経済活動への影響が懸念される状況にあります。

半導体業界におきましては、AIを活用したサービスの急速な拡大等を背景に、メモリをはじめとして半導体需要の回復が期待されるものの、パソコン、サーバーおよびスマートフォン市場の回復の遅れや半導体の在庫調整がさらに長期化する懸念が払拭できない状況が継続することも想定されます。一方、DX（Digital Transformation）の進展等による社会・経済のデジタル化や、持続可能な成長の実現を目指す脱炭素社会への移行と情報通信量の大幅な増加による電力消費の抑制を両立するGX（Green Transformation）の実現を支えるキーテクノロジーとして、半導体の重要性が高まるとともに、高度化・多様化する市場のニーズや需要動向の変化に対し、迅速

かつ柔軟に対応し得る開発・生産体制を構築することを要するなど、世界規模での競争が一段と激化することが見込まれます。また、半導体のさらなる高機能化・多機能化のニーズへの対応をはかるうえで、半導体製造におけるパッケージングプロセスの重要性が高まっており、特に、当社が主な事業内容とする半導体パッケージは、半導体の一層の高機能化・高速化と省電力対応に欠くことのできない中核製品として半導体産業におけるニーズがさらに高まることが想定されます。

このような環境下であって、当社グループといたしましては、営業体制の一層の強化に努め、市場環境の変化を的確に把握し、積極的な受注活動を展開することなどにより売上確保をはかるとともに、全社において生産性向上・効率化、徹底したコストダウン等の取り組みを強化してまいります。また、これまで高い成長が見込まれる市場向けに継続的・重点的に経営資源の投下をはかってまいりましたが、市場環境をふまえ、必要により時期・内容を適切に判断のうえ、引き続き当社製品の中長期的な市場拡大を見据えた設備投資を展開してまいります。半導体の一層の高機能化・高速化や省電力化等のニーズに対応するフリップチップタイプパッケージについて、昨年12月に竣工した千曲工場（長野県千曲市）における量産体制整備等をはかるとともに、半導体メモリーの高速化・大容量化に対応するプラスチックBGA基板については、生産能力増強を目的として新井工場（新潟県妙高市）において着工した新棟建設を着実に実行してまいります。加えて、中長期的に大きな成長が見込まれるHPC（ハイパフォーマンスコンピューティング）市場のニーズに対応する当社開発の「i-THOP<sup>®</sup>」をはじめとする先端半導体向け次世代フリップチップタイプパッケージの千曲工場における新たな設備投資計画を推進するとともに、情報通信量の大幅な増加に対応する次世代情報通信基盤の構築における基幹デバイスとして、消費電力の飛躍的な低減とデータ処理の超高速化を実現する「光電融合デバイス」の開発に注力するなど、これまで培ってまいりました最先端の半導体実装技術をもとに、市場ニーズを先取りした新商品・新技術の確立・量産化に取り組み、持続的な成長・発展を目指してまいります。

さらに、厳しい事業環境において、収益基盤の一層の強化をはかるべく、開発・設計から生産に至るすべての段階において品質を造り込み、優れた製品を安定的に供給することができる生産体制の確立に努めてまいります。

当社グループは、引き続き成長が見込まれる半導体市場にあって、常にお客様のニーズを起点とし、機能・性能、コスト、品質すべてにおいてお客様にとって価値の高い製品・サービスを提供することにより、「限りなき発展」を果たしてまいり所存であります。

以上の状況をふまえ、2025年3月期の連結業績予想といたしましては、売上高2,500億円、経常利益450億円、親会社株主に帰属する当期純利益300億円を見込んでおります。なお、業績予想の前提となる為替レートは、1米ドル=135円を想定しております。

## (2) 当期の財政状態の概況

### ① 資産、負債および純資産の状況

当連結会計年度末における財政状態につきましては、前連結会計年度末に比べ総資産が68億16百万円増加し3,937億50百万円となりました。負債は71億46百万円減少し1,287億73百万円となりました。純資産は139億63百万円増加し2,649億77百万円となりました。この結果、自己資本比率は67.3%となりました。

## ② キャッシュ・フローの状況

当連結会計年度において、営業活動の結果得られた資金は454億64百万円（前連結会計年度比727億59百万円減）となりました。また、投資活動の結果使用した資金は732億73百万円（同80億74百万円増）となりました。財務活動の結果使用した資金は68億86百万円（同3億10百万円減）となりました。

これらの活動の結果に為替換算差額を加味した当連結会計年度末における現金及び現金同等物の残高は、前連結会計年度末に比べ331億16百万円減少し824億75百万円となりました。

## (3) 利益配分に関する基本方針および当期・次期の配当

当社は、株主の皆様への利益還元を充実させていくことを経営の最重要施策の一つと考えており、半導体業界の急速な技術革新に対応した設備投資や研究開発投資を通じた強固な企業基盤の確立と将来の事業展開に備えるため、内部留保の充実も考慮し、財政状態、利益水準および配当性向などを総合的に勘案した利益配当を行うことを基本方針としてまいりました。

当連結会計年度における配当につきましては、2023年12月12日に公表いたしました「2024年3月期の期末配当予想の修正（無配）および株主優待制度の廃止に関するお知らせ」のとおり、同日別途公表した「J I C C - 0 4 株式会社による当社株式に対する公開買付けの開始予定に係る賛同の意見表明及び応募推奨に関するお知らせ」に記載のJ I C C - 0 4 株式会社による当社の普通株式に対する公開買付けが行われる予定であることをふまえ、期末配当を行わないことを決定しているため、年間では1株当たり25円（中間配当）となります。

また、2025年3月期の中間配当及び期末配当についても行わないことを予定しております。

## 2. 経営方針

### (1) 経営の基本方針

当社は、中長期的な成長が見込まれるエレクトロニクス産業にあつて、半導体の進化を支え、半導体の優れた機能を人々の生活へと繋ぐテクノロジーをもとに、世界中の人々の暮らしを豊かに彩るものづくりに取り組むとともに、お客様のニーズを起点とする優れた製品を開発・製造・販売することによって、「限りなき発展」を目指しています。

また、このような「技術力」、「発展性」とともに、「国際性」、「温かさ」を企業理念として掲げ、世界各国のお客様と取引を行い、各地に拠点を展開するグローバル企業として国際社会での共存共栄を念頭に置き、多様な人材の能力を結集し、社員一人ひとりの成長を実現できる環境づくりに努め、「人と地球環境への温かさ」を考えた経営姿勢で事業を推進することにより、社会の健全な発展に寄与し、輝かしい未来の創造に貢献することを目指しています。

### (2) 中長期的な経営戦略

超高速大容量通信を実現する情報通信基盤の進化や AI、IoT の急速な利用拡大等を背景とする DX (Digital Transformation) の進展が、経済や社会の仕組みに大きな変化をもたらし、これまでとは次元の異なるイノベーションを生み出す可能性を秘めており、半導体は、その可能性を実現するキーテクノロジーとして革新を続けていくことが期待されるとともに、戦略的な観点からもその重要性がさらに高まる状況にあります。また、自動運転やコネクテッドカー等の技術開発が加速する自動車市場や多様な分野での活用が期待されるロボティクスなど、半導体は、今後も市場を拡大することが見込まれています。加えて、脱炭素社会への移行に向けた取り組みを加速し、GX (Green Transformation) の実現に不可欠なテクノロジーの進化を支えるキーデバイスとして、半導体のニーズはさらに高度化・多様化することが想定されます。

一方で、高機能化・高速化等の技術革新および絶えず変化する市場ニーズに対し、迅速かつ柔軟に対応し得る開発・生産体制を構築することを要するなど、世界規模での競争が、さらに一段と激化することが予想されます。

このような産業にあつて、当社グループは、インターコネクトテクノロジーをベースに、高い競争力を持つ製品の開発とものづくりの革新に努め、お客様にとって、機能・性能、コスト、品質すべてにおいて価値の高い製品・サービスをご提供することにより、お客様の成功を支え、自らの発展・成長を目指してまいります。加えて、市場ニーズや変化を先取りした新商品や新技術の開発に注力するとともに、変化の激しい需要環境にも柔軟かつ効率的に対応できる生産体制の構築に取り組んでまいります。また、キャッシュ・フローを重視し、常に利益を創出できる強固な経営基盤の確立に努め、かつコーポレート・ガバナンスの充実をはかるとともに、以下の項目に重点をおいた経営戦略を展開してまいります。

#### ① 成長分野への重点的展開

今後、市場拡大の一方で、高性能化・高機能化のニーズを背景にテクノロジーの高度化が見込まれる半導体産業にあつて、お客様のニーズを的確にとらえ、それを実現する開発力・製造力の充実・革新に努めるとともに、創業以来培ってきたコアテクノロジーをもとに、高い成長が見込まれる分野に重点的に経営資源を投下し、強い競争力を有する製品の開発・量産化を推進することにより、さらなる成長を目指してまいります。



また、常に新たな市場機会を追求し、高い将来性が見込まれる市場や製品分野の探求に注力することを通じて、持続可能な成長を果たしてまいります。

## ② 強固な生産体制の構築

市場環境の変化が激しく、熾烈な競争が繰り返される半導体産業にあって、市場の変化に速やかに対応する強固な生産体制を構築することが企業存続・発展の条件ととらえ、全社において、製造プロセスの革新と最適化を強力に推進いたします。また、開発・設計から生産に至るすべての段階において品質を造り込み、優れた製品を安定的に供給することができる体制を確立することにより、収益基盤の一層の強化をはかってまいります。

## ③ SHINKO Wayの推進

社会における新光電気グループの存在意義、大切にすべき価値観、および社員が実践すべき行動指針、守るべき行動規範を示した「SHINKO Way」の実践を通じ、株主の皆様のご期待に応え、お客様、お取引先、地域社会の皆様や社員をはじめとするステークホルダーの方々との調和をはかるとともに、多様なサステナビリティ課題に対する活動の推進を通じて、持続可能な社会の実現に貢献することを目指しています。なかでも、地球環境における喫緊の課題である気候変動への対応を最重要な課題と位置づけ、カーボンニュートラルの早期実現をはかるべく、グループ全体における取り組みを加速してまいります。

なお、今後、当社株式については、J I Cキャピタル株式会社を中心に構成される公開買付者による公開買付けの実施が予定されています。

当社は、市況環境変化の激しい半導体産業にあって、当社製品・テクノロジーの中長期的な市場拡大の可能性を的確に捉え、機動的かつ柔軟な経営判断を行うことが重要との認識に基づき、成長市場向けの設備投資・技術開発を重点的に展開する当社の事業方針を基本的に支持し、政府系ファンドとして短期的な業績変動に動じず、中長期的な観点で企業価値の向上に資する取組みを推進していくことが可能なJ I Cキャピタル株式会社を中心に構成される公開買付者による本公開買付けに賛同の意見を表明するとともに、当社の株主の皆様の本公開買付けへの応募を推奨することといたしました。今後、本公開買付けおよびその後に予定された手続により、当社株式を非公開化することを目的とする一連の取引を実行し、これまで以上の意思決定のスピードアップをはかり、当社事業推進において根幹となる人的資本の拡充などの施策を進めるとともに、次世代半導体ビジネスの推進や次世代製品における市場競争力の強化等に取り組み、中長期的かつ持続的な企業価値向上を目指し「限りなき発展」を果たしてまいります。

## 3. 会計基準の選択に関する基本的な考え方

当社グループは、連結財務諸表の期間比較可能性および企業間の比較可能性を考慮し、当面は、日本基準で連結財務諸表を作成する方針であります。

なお、国際会計基準の適用につきましては、国内外の諸情勢を考慮の上、検討を進めていく方針であります。

## 4. 連結財務諸表および主な注記

## (1) 連結貸借対照表

(単位：百万円)

	前連結会計年度 (2023年3月31日)	当連結会計年度 (2024年3月31日)
<b>資産の部</b>		
流動資産		
現金及び預金	116,325	82,807
受取手形	222	240
売掛金	62,134	56,475
商品及び製品	10,397	8,583
仕掛品	13,755	14,245
原材料及び貯蔵品	11,014	7,963
その他	12,231	14,150
貸倒引当金	△6	△6
流動資産合計	226,075	184,459
固定資産		
有形固定資産		
建物及び構築物（純額）	37,885	78,118
機械装置及び運搬具（純額）	45,434	38,317
工具、器具及び備品（純額）	3,184	3,814
土地	7,687	10,255
建設仮勘定	59,876	71,478
有形固定資産合計	154,068	201,984
無形固定資産	876	1,175
投資その他の資産		
投資有価証券	48	53
退職給付に係る資産	2,005	2,524
繰延税金資産	3,446	2,459
その他	419	1,102
貸倒引当金	△8	△8
投資その他の資産合計	5,912	6,131
固定資産合計	160,858	209,291
資産合計	386,934	393,750

(単位：百万円)

	前連結会計年度 (2023年3月31日)	当連結会計年度 (2024年3月31日)
<b>負債の部</b>		
流動負債		
買掛金	24,565	28,164
短期借入金	30,000	30,000
未払金	13,483	17,306
未払法人税等	12,073	3,366
未払費用	10,245	10,053
契約負債	41,535	35,912
その他	1,642	2,143
流動負債合計	133,545	126,946
固定負債		
退職給付に係る負債	1,847	1,101
その他	526	725
固定負債合計	2,374	1,826
負債合計	135,919	128,773
純資産の部		
株主資本		
資本金	24,223	24,223
資本剰余金	24,173	24,222
利益剰余金	203,882	215,736
自己株式	△74	△61
株主資本合計	252,205	264,119
その他の包括利益累計額		
その他有価証券評価差額金	1	4
繰延ヘッジ損益	14	△103
為替換算調整勘定	△612	513
退職給付に係る調整累計額	△594	443
その他の包括利益累計額合計	△1,190	857
純資産合計	251,014	264,977
負債純資産合計	386,934	393,750

(2) 連結損益計算書及び連結包括利益計算書  
(連結損益計算書)

(単位：百万円)

	前連結会計年度 (自 2022年4月1日 至 2023年3月31日)	当連結会計年度 (自 2023年4月1日 至 2024年3月31日)
売上高	286,358	209,972
売上原価	194,664	171,070
売上総利益	91,693	38,902
販売費及び一般管理費	14,980	14,091
営業利益	76,712	24,810
営業外収益		
受取利息	432	686
受取補償金	209	789
為替差益	1,233	600
雑収入	266	454
営業外収益合計	2,142	2,530
営業外費用		
支払利息	64	67
雑支出	34	16
営業外費用合計	99	83
経常利益	78,755	27,257
特別利益		
補助金収入	—	784
特別利益合計	—	784
特別損失		
固定資産除却損	1,295	842
固定資産圧縮損	—	784
公開買付関連費用	—	500
特別損失合計	1,295	2,126
税金等調整前当期純利益	77,460	25,915
法人税、住民税及び事業税	23,041	6,750
法人税等調整額	△69	555
法人税等合計	22,971	7,305
当期純利益	54,488	18,609
親会社株主に帰属する当期純利益	54,488	18,609

(連結包括利益計算書)

(単位：百万円)

	前連結会計年度 (自 2022年4月1日 至 2023年3月31日)	当連結会計年度 (自 2023年4月1日 至 2024年3月31日)
当期純利益	54,488	18,609
その他の包括利益		
その他有価証券評価差額金	0	2
繰延ヘッジ損益	429	△117
為替換算調整勘定	704	1,125
退職給付に係る調整額	424	1,037
その他の包括利益合計	1,558	2,048
包括利益	56,047	20,657
(内訳)		
親会社株主に係る包括利益	56,047	20,657
非支配株主に係る包括利益	—	—

(3) 連結株主資本等変動計算書

前連結会計年度 (自 2022年4月1日 至 2023年3月31日)

(単位: 百万円)

	株主資本				
	資本金	資本剰余金	利益剰余金	自己株式	株主資本合計
当期首残高	24,223	24,129	156,486	△92	204,746
当期変動額					
剰余金の配当			△7,092		△7,092
親会社株主に帰属する当期純利益			54,488		54,488
自己株式の取得				△0	△0
自己株式の処分		44		18	62
株主資本以外の項目の当期変動額 (純額)					
当期変動額合計	—	44	47,395	18	47,458
当期末残高	24,223	24,173	203,882	△74	252,205

	その他の包括利益累計額					純資産合計
	その他有価証券評価差額金	繰延ヘッジ損益	為替換算調整勘定	退職給付に係る調整累計額	その他の包括利益累計額合計	
当期首残高	0	△414	△1,316	△1,019	△2,749	201,997
当期変動額						
剰余金の配当						△7,092
親会社株主に帰属する当期純利益						54,488
自己株式の取得						△0
自己株式の処分						62
株主資本以外の項目の当期変動額 (純額)	0	429	704	424	1,558	1,558
当期変動額合計	0	429	704	424	1,558	49,017
当期末残高	1	14	△612	△594	△1,190	251,014

当連結会計年度 (自 2023年4月1日 至 2024年3月31日)

(単位: 百万円)

	株主資本				
	資本金	資本剰余金	利益剰余金	自己株式	株主資本合計
当期首残高	24,223	24,173	203,882	△74	252,205
当期変動額					
剰余金の配当			△6,755		△6,755
親会社株主に帰属する当期純利益			18,609		18,609
自己株式の取得				△0	△0
自己株式の処分		48		12	61
株主資本以外の項目の当期変動額 (純額)					
当期変動額合計	—	48	11,854	12	11,914
当期末残高	24,223	24,222	215,736	△61	264,119

	その他の包括利益累計額					純資産合計
	その他有価証券評価差額金	繰延ヘッジ損益	為替換算調整勘定	退職給付に係る調整累計額	その他の包括利益累計額合計	
当期首残高	1	14	△612	△594	△1,190	251,014
当期変動額						
剰余金の配当						△6,755
親会社株主に帰属する当期純利益						18,609
自己株式の取得						△0
自己株式の処分						61
株主資本以外の項目の当期変動額 (純額)	2	△117	1,125	1,037	2,048	2,048
当期変動額合計	2	△117	1,125	1,037	2,048	13,963
当期末残高	4	△103	513	443	857	264,977

## (4) 連結キャッシュ・フロー計算書

(単位：百万円)

	前連結会計年度 (自 2022年4月1日 至 2023年3月31日)	当連結会計年度 (自 2023年4月1日 至 2024年3月31日)
<b>営業活動によるキャッシュ・フロー</b>		
税金等調整前当期純利益	77,460	25,915
減価償却費	34,750	27,639
退職給付に係る負債の増減額 (△は減少)	△354	△171
受取利息及び受取配当金	△436	△691
支払利息	64	67
為替差損益 (△は益)	△300	△478
補助金収入	—	△784
有形固定資産除却損	1,294	842
固定資産圧縮損	—	784
公開買付関連費用	—	500
売上債権の増減額 (△は増加)	15,193	7,116
棚卸資産の増減額 (△は増加)	△193	4,528
仕入債務の増減額 (△は減少)	△13,538	1,874
未払費用の増減額 (△は減少)	△569	△261
契約負債の増減額 (△は減少)	36,108	△5,623
その他	△1,251	△1,612
小計	148,226	59,644
利息及び配当金の受取額	430	695
利息の支払額	△64	△65
法人税等の支払額又は還付額 (△は支払)	△30,368	△15,094
補助金の受取額	—	784
公開買付関連費用の支払額	—	△500
営業活動によるキャッシュ・フロー	118,223	45,464
<b>投資活動によるキャッシュ・フロー</b>		
定期預金の預入による支出	△1,505	△875
定期預金の払戻による収入	1,503	1,341
有形固定資産の取得による支出	△63,697	△71,928
無形固定資産の取得による支出	△255	△503
投資及び長期貸付金の増減額 (△は増加)	△188	△822
その他	△1,054	△485
投資活動によるキャッシュ・フロー	△65,199	△73,273
<b>財務活動によるキャッシュ・フロー</b>		
配当金の支払額	△7,092	△6,755
その他	△104	△130
財務活動によるキャッシュ・フロー	△7,197	△6,886
現金及び現金同等物に係る換算差額	1,006	1,578
現金及び現金同等物の増減額 (△は減少)	46,833	△33,116
現金及び現金同等物の期首残高	68,758	115,592
現金及び現金同等物の期末残高	115,592	82,475



## (5) 連結財務諸表に関する注記事項

## (継続企業の前提に関する注記)

該当事項はありません。

## (連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項)

## 1. 連結の範囲に関する事項

## (1) 連結子会社の数 8社

※主要会社名：

SHINKO ELECTRONICS (MALAYSIA) SDN. BHD.、KOREA SHINKO MICROELECTRONICS CO., LTD.、  
SHINKO ELECTRIC AMERICA, INC.

前連結会計年度において連結子会社でありましたSHINKO ELECTRIC INDUSTRIES (WUXI) CO., LTD.は清算したため、連結の範囲から除いております。

## (2) 非連結子会社の名称

非連結子会社 SHINKO MICROELECTRONICS (THAILAND) CO., LTD.

## 2. 連結子会社の事業年度等に関する事項

連結子会社の決算日

12月末 1社

3月末 7社

12月末日決算会社は、12月末決算により連結しております。

連結決算日の不一致による差異に重要なものがある場合には連結決算上調整を行うこととしております。

## 3. 会計方針に関する事項

## (1) 重要な資産の評価基準および評価方法

## ① 有価証券

その他有価証券

市場価格のない株式等以外のもの……時価法（評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定）を採用しております。

市場価格のない株式等……移動平均法による原価法を採用しております。

## ② デリバティブ

時価法を採用しております。

## ③ 棚卸資産

総平均法および先入先出法による原価法（貸借対照表価額は収益性の低下に基づく簿価切下げの方法により算定）を採用しております。

## (2) 重要な減価償却資産の減価償却の方法

## ① 有形固定資産（リース資産を除く）

主に定率法によっております。ただし、当社および国内連結子会社については、1998年4月1日以降に取得した建物（建物附属設備を除く。）ならびに2016年4月1日以降に取得した建物附属設備および構築物については、定額法を採用しております。

## ② 無形固定資産

定額法によっております。なお、自社利用のソフトウェアについては、社内における利用可能期間（5年）に基づく定額法によっております。

### ③リース資産

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産について、リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法を採用しております。

## (3)重要な引当金の計上基準

### ①貸倒引当金

売上債権等の貸倒損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を勘案し、回収不能見込額を計上しております。

### ②役員賞与引当金

当社は役員賞与の支出に備えて、当連結会計年度における支給見込額に基づき計上しております。

## (4)退職給付に係る会計処理の方法

### ①退職給付見込額の期間帰属方法

退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当連結会計年度末までの期間に帰属させる方法については、給付算定式基準によっております。

### ②数理計算上の差異および過去勤務費用の費用処理方法

過去勤務費用については、その発生時における従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数（10年）による定額法により費用処理しております。

数理計算上の差異については、各連結会計年度の発生時における従業員の平均残存勤務年数による定額法により按分した額を、それぞれ発生の翌連結会計年度から費用処理しております。

## (5)重要な収益および費用の計上基準

当社および連結子会社の顧客との契約から生じる収益に関する主要な事業における主な履行義務の内容および当該履行義務を充足する通常の時点（収益を認識する通常の時点）は以下のとおりであります。

当社グループは、半導体パッケージの開発・製造・販売を主な事業内容としております。このような製品の販売については、顧客ごとの契約条件に基づいて当該製品に対する支配を顧客に移転することにより履行義務が充足される時に収益を認識しております。また、製品の販売について、得意先から部品を仕入、加工を行った上で加工費等を仕入価格に上乗せして加工品を当該得意先に対して販売する取引については、売上高と売上原価を純額表示しております。なお、製品の国内販売において、出荷時から当該製品の支配が顧客に移転される時までの期間が通常の間である場合には、出荷時に収益を認識しております。

## (6)重要な外貨建の資産または負債の本邦通貨への換算の基準

外貨建金銭債権債務は、連結決算日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は損益として処理しております。なお、在外子会社の資産、負債、収益および費用は、在外子会社の決算日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は純資産の部における為替換算調整勘定に含めております。

## (7)重要なヘッジ会計の方法

繰延ヘッジ処理を採用しております。

## (8)連結キャッシュ・フロー計算書における資金の範囲

連結キャッシュ・フロー計算書における資金（現金及び現金同等物）は、手許現金、随時引き出し可能な預金および容易に換金可能であり、かつ、価値の変動について僅少なりスクしか負わない取得日から3ヶ月以内に償還期限の到来する短期投資からなっております。

(追加情報)

(公開買付け)

当社は、2023年12月12日開催の取締役会において、J I C C - 0 4 株式会社（以下「公開買付者」という。）による当社の普通株式（以下「当社株式」という。）に対する公開買付け（以下「本公開買付け」という。）に関して、同日時点における当社の意見として、本公開買付けが開始された場合には、本公開買付けに賛同の意見を表明するとともに、当社の株主の皆様に対して、本公開買付けに応募することを推奨する旨の決議をいたしました。

なお、当社の上記取締役会決議は、公開買付者が本公開買付けおよびその後に予定された一連の手続により、当社株式の全てを取得することを企図していること、および当社株式が上場廃止となる予定であることを前提としております。

1. 公開買付者の概要

(1) 名称	J I C C - 0 4 株式会社
(2) 所在地	東京都港区虎ノ門一丁目3番1号
(3) 代表者の役職・氏名	代表取締役 板橋 理
(4) 事業内容	①会社の株式または持分を所有することにより、当該会社の事業活動を支配、管理する業務 ②その他前号に掲げる事業に付帯または関連する事業
(5) 資本金	100,000円
(6) 設立年月日	2023年9月29日
(7) 大株主および持株比率	J I C キャピタル株式会社 100%
(8) 当社と公開買付者の関係	
資本関係	該当事項はありません。
人的関係	該当事項はありません。
取引関係	該当事項はありません。
関連当事者への該当状況	該当事項はありません。

2. 本公開買付けの概要

(1) 買付け等の期間

本公開買付けは、国内外の競争法ならびに国外の投資規制法令等に基づく必要な手続および対応に一定期間を要することが想定されているため、本公開買付けの開始時期については、公開買付者により、2024年8月下旬が目指されてはいるものの、国外の競争当局および投資規制法令等を所管する当局における手続等に要する期間に影響されます。また、公開買付期間は20営業日となる予定です。

(2) 買付け等の価格

普通株式1株につき、5,920円

(3) 買付予定の株券等の数

買付予定数	買付予定数の下限	買付予定数の上限
67,530,488株	22,491,400株	一株

## (セグメント情報)

## 1. 報告セグメントの概要

当社グループの報告セグメントは、当社グループの構成単位のうち分離された財務情報が入手可能であり、取締役会が経営資源の配分の決定および業績を評価するために、定期的に検討を行う対象となっているものであります。

当社グループは、半導体パッケージの開発・製造・販売を主な事業内容としており、製品の種類や特性によって分類された事業区分に基づき、国内および海外の包括的な戦略を立案し、事業活動を展開しております。

したがって、当社グループは、当該事業区分を基礎とした製品別のセグメントから構成されており、「プラスチックパッケージ」および「メタルパッケージ」の2つを報告セグメントとしております。

「プラスチックパッケージ」は、プラスチック・ラミネート・パッケージ等の製造・販売およびICの組立・販売を行っております。「メタルパッケージ」は、半導体用リードフレーム、半導体用ガラス端子およびセラミック静電チャック等の製造・販売を行っております。

## 2. 報告セグメントごとの売上高、利益または損失、資産、負債その他の項目の金額の算定方法

報告されている事業セグメントの会計処理の方法は、「連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項」における記載と概ね同一であります。

セグメント間の売上高は、主に第三者間取引価格に基づいております。

## 3. 報告セグメントごとの売上高、利益または損失、資産、負債その他の項目の金額に関する情報

前連結会計年度（自 2022年4月1日 至 2023年3月31日）

(単位:百万円)

	報告セグメント			その他 (注) 1	合計	調整額 (注) 2 (注) 4	連結 財務諸表 計上額 (注) 3
	プラスチック パッケージ	メタル パッケージ	計				
売上高							
一時点で移転される財	176,844	99,284	276,128	10,229	286,358	—	286,358
一定の期間にわたり移 転される財	—	—	—	—	—	—	—
ICリードフレーム	—	43,113	43,113	6,546	49,659	—	49,659
ICパッケージ	176,844	10,957	187,802	135	187,938	—	187,938
気密部品	—	45,213	45,213	3,531	48,744	—	48,744
その他	—	—	—	15	15	—	15
顧客との契約から生じ る収益	176,844	99,284	276,128	10,229	286,358	—	286,358
その他の収益	—	—	—	—	—	—	—
外部顧客への売上高	176,844	99,284	276,128	10,229	286,358	—	286,358
セグメント間の内部 売上高または振替高	—	301	301	4,676	4,977	△4,977	—
計	176,844	99,585	276,430	14,905	291,335	△4,977	286,358
セグメント利益	47,331	31,224	78,556	2,927	81,483	△2,728	78,755
その他の項目							
減価償却費	28,334	6,019	34,353	396	34,750	—	34,750
有形固定資産および 無形固定資産の増加額	14,124	3,230	17,355	184	17,539	8,474	26,014

- (注) 1. 「その他」の区分は、報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、主に連結子会社の事業によるものであります。
2. セグメント利益の調整額△2,728百万円は、セグメント間取引消去によるものであります。
3. セグメント利益は、連結損益計算書の経常利益と調整を行っております。
4. 有形固定資産および無形固定資産の増加額の調整額8,474百万円は、主に全社共通部門における投資額であります。
5. セグメント資産は、事業セグメントに資産を配分していないため、記載しておりません。

当連結会計年度 (自 2023年4月1日 至 2024年3月31日)

(単位:百万円)

	報告セグメント			その他 (注) 1	合計	調整額 (注) 2 (注) 4	連結 財務諸表 計上額 (注) 3
	プラスチック パッケージ	メタル パッケージ	計				
売上高							
一時点で移転される財	127,752	73,878	201,631	8,341	209,972	—	209,972
一定の期間にわたり移 転される財	—	—	—	—	—	—	—
I Cリードフレーム	—	33,971	33,971	4,908	38,880	—	38,880
I Cパッケージ	127,752	5,518	133,270	285	133,556	—	133,556
気密部品	—	34,388	34,388	3,143	37,531	—	37,531
その他	—	—	—	3	3	—	3
顧客との契約から生じ る収益	127,752	73,878	201,631	8,341	209,972	—	209,972
その他の収益	—	—	—	—	—	—	—
外部顧客への売上高	127,752	73,878	201,631	8,341	209,972	—	209,972
セグメント間の内部 売上高または振替高	—	430	430	3,611	4,041	△4,041	—
計	127,752	74,308	202,061	11,952	214,014	△4,041	209,972
セグメント利益	11,828	16,133	27,962	1,099	29,061	△1,803	27,257
その他の項目							
減価償却費	20,507	6,369	26,877	761	27,639	—	27,639
有形固定資産および 無形固定資産の増加額	6,391	2,680	9,071	551	9,623	54,573	64,197

- (注) 1. 「その他」の区分は、報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、主に連結子会社の事業によるものであります。
2. セグメント利益の調整額△1,803百万円は、セグメント間取引消去によるものであります。
3. セグメント利益は、連結損益計算書の経常利益と調整を行っております。
4. 有形固定資産および無形固定資産の増加額の調整額54,573百万円は、主に全社共通部門における投資額であります。
5. セグメント資産は、事業セグメントに資産を配分していないため、記載しておりません。

(1株当たり情報)

	前連結会計年度 (自 2022年4月1日 至 2023年3月31日)	当連結会計年度 (自 2023年4月1日 至 2024年3月31日)
1株当たり純資産額	1,857.90円	1,961.09円
1株当たり当期純利益金額	403.32円	137.73円

(注) 1. 潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。

2. 1株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。

	前連結会計年度 (自 2022年4月1日 至 2023年3月31日)	当連結会計年度 (自 2023年4月1日 至 2024年3月31日)
親会社株主に帰属する当期純利益金額 (百万円)	54,488	18,609
普通株主に帰属しない金額 (百万円)	—	—
普通株式に係る親会社株主に帰属する当期純利益金額 (百万円)	54,488	18,609
期中平均株式数 (千株)	135,101	135,114

(重要な後発事象)

該当事項はありません。

参考資料



2024年4月25日  
新光電気工業株式会社

2024年3月期 連結および単独決算概要

[連結]

1. 業績等の概況

(単位：百万円)

	2023年3月期	2024年3月期	増減率 (%)	2025年3月期 (予想)	増減率 (%)
	(2022年4月1日から 2023年3月31日まで)	(2023年4月1日から 2024年3月31日まで)		(2024年4月1日から 2025年3月31日まで)	
売上高	286,358	209,972	△26.7	250,000	19.1
営業利益	76,712	24,810	△67.7	44,000	77.3
経常利益	78,755	27,257	△65.4	45,000	65.1
親会社株主に帰属する 当期純利益	54,488	18,609	△65.8	30,000	61.2
1株当たり当期純利益	403円32銭	137円73銭		222円3銭	
総資産	386,934	393,750			
純資産	251,014	264,977			
自己資本比率	64.9%	67.3%			
設備投資額*	25,758	63,693		49,100	
減価償却費*	34,511	27,435		35,500	
研究開発費	3,580	3,496		3,900	
為替レート(1米ドル)	134円	143円		135円	

\* 無形固定資産を除く

2. セグメント情報

(単位：百万円)

セグメント		2023年3月期		2024年3月期		増減率 (%)
		(2022年4月1日から 2023年3月31日まで)		(2023年4月1日から 2024年3月31日まで)		
売上高*1	プラスチックパッケージ	176,844	構成比(%) (61.7)	127,752	構成比(%) (60.8)	△27.8
	メタルパッケージ	99,284	(34.7)	73,878	(35.2)	△25.6
	その他	10,229	(3.6)	8,341	(4.0)	△18.5
	合計	286,358	(100.0)	209,972	(100.0)	△26.7
経常利益*2	プラスチックパッケージ	47,331	利益率(%) (26.8)	11,828	利益率(%) (9.3)	△75.0
	メタルパッケージ	31,224	(31.4)	16,133	(21.8)	△48.3
	その他 / 調整額	198		△704		
	合計	78,755	(27.5)	27,257	(13.0)	△65.4

\*1 外部顧客への売上高

\*2 セグメント間取引調整前の経常利益

3. 部門別売上高

(単位：百万円)

部 門	2023年3月期 (2022年4月1日から 2023年3月31日まで)		2024年3月期 (2023年4月1日から 2024年3月31日まで)		増減率 (%)
		構成比(%)		構成比(%)	
I C リードフレーム	49,659	(17.4)	38,880	(18.5)	△21.7
I C パッケージ	187,938	(65.6)	133,556	(63.6)	△28.9
気 密 部 品	48,744	(17.0)	37,531	(17.9)	△23.0
そ の 他	15	(0.0)	3	(0.0)	△75.3
合 計	286,358	(100.0)	209,972	(100.0)	△26.7

[単 独]

1. 業績等の概況

(単位：百万円)

	2023年3月期 (2022年4月1日から 2023年3月31日まで)	2024年3月期 (2023年4月1日から 2024年3月31日まで)	増減率 (%)
売 上 高	276,581	202,350	△26.8
営 業 利 益	73,628	23,735	△67.8
経 常 利 益	78,587	28,014	△64.4
当 期 純 利 益	54,850	19,480	△64.5
1株当たり当期純利益	406円00銭	144円18銭	
総 資 産	381,917	388,261	
純 資 産	247,493	260,164	
自 己 資 本 比 率	64.8%	67.0%	
1株当たり配当金	50円	25円	